

天津金海通半导体设备股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构(主承销商)：海通证券股份有限公司

天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“金海通”、“发行人”或“公司”）首次公开发行 1,500.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2023]83 号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“金海通”，扩位证券简称为“金海通股份”，证券代码为“603061”。

本次发行采用网上按市值申购向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行，不进行网下询价和配售。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 58.58 元/股，发行数量为 1,500.00 万股，全部为新股发行，无老股转让。本次发行中网上发行数量为 1,500.00 万股，占本次发行总量的 100.00%

本次发行的网上认购缴款工作已于 2023 年 2 月 22 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网上发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量：14,812,003 股
- 2、网上投资者缴款认购的金额：867,687,135.74 元
- 3、网上投资者放弃认购数量：187,997 股
- 4、网上投资者放弃认购金额：11,012,864.26 元

二、保荐机构（主承销商）包销情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]，以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142 号，以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142 号，以下简称“《配售细则》”），网上投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 187,997 股，包销金额为 11,012,864.26 元，保荐机构（主承销商）包销股份占本次发行股数的比例为 1.25%。

2023 年 2 月 24 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

网上投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。

具体联系方式如下：

联系电话：021-23219512

联系人：资本市场部

发行人：天津金海通半导体设备股份有限公司
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

2023 年 2 月 24 日

(本页无正文，为《天津金海通半导体设备股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)



发行人：天津金海通半导体设备股份有限公司

2013年2月24日

（本页无正文，为《天津金海通半导体设备股份有限公司首次公开发行股票发行
结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司



2013年7月29日